

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 11 月 20 日(20.11.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/185003 A1

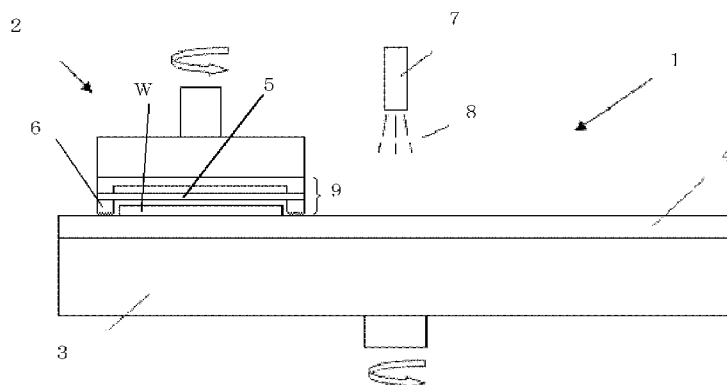
- (51) 国際特許分類:
B24B 37/32 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/002066
- (22) 国際出願日: 2014 年 4 月 10 日(10.04.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-103719 2013 年 5 月 16 日(16.05.2013) JP
- (71) 出願人: 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HAN-
DOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田
区大手町二丁目 6 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 橋本 浩昌 (HASHIMOTO, Hiromasa); 〒
9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大
平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場内
Fukushima (JP). 佐々木 正直 (SASAKI, Masanao);
〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字
大平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場
内 Fukushima (JP).
- (74) 代理人: 好宮 幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒
1100005 東京都台東区上野 7 丁目 6 番 1 1 号第
一下谷ビル 8 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: WORKPIECE POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: ワークの研磨装置



(57) Abstract: The present invention is a workpiece polishing device comprising a polishing cloth for polishing a workpiece, a polish supply mechanism for supplying polish, and a polishing head for holding the workpiece; the polishing head holding the back surface of the workpiece by a backing pad and holding the edge part of the workpiece by an annular template, and pressing the workpiece and the template against the polishing cloth, whereby the workpiece is rubbed against the polishing cloth and the workpiece is polished, wherein the workpiece polishing device is characterized in that the template is composed of a resin to which a filler is added or a resin in which a woven cloth is included, and minuscule concavities are formed in the surface pressing against the polishing cloth by exposing the filler or the woven cloth on the surface. A workpiece polishing device is thereby provided in which the speed of polishing the outer periphery of the workpiece is stable and the workpiece can be polished with high flatness.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/185003 A1



本発明は、ワークを研磨するため研磨布と、研磨剤を供給するための研磨剤供給機構と、ワークを保持するための研磨ヘッドを具備し、該研磨ヘッドは前記ワークの裏面をバックアップパッドによって保持し、前記ワークのエッジ部を環状のテンプレートによって保持し、研磨布にワークとテンプレートを押圧することで、ワークを研磨布に摺接させ、ワークを研磨するワークの研磨装置であって、テンプレートは、フィラーが添加された樹脂又は織布が含まれた樹脂から成り、研磨布を押圧する面にフィラー又は織布が露出していることにより、該押圧する面に微細な凹部を有するものであることを特徴とするワークの研磨装置である。これにより、ワーク外周部の研磨速度が安定し、高平坦にワークを研磨できるワークの研磨装置を提供される。